二　半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置

イ　半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　多結晶シリコン及び貨物等省令第六条第十八号に該当する貨物の製造用の装置

（二）　Ⅲ－Ⅴ族及びⅡ－Ⅵ族の半導体物質（貨物等省令第六条第十八号から第二十三号までのいずれかに該当するものに限る。）の製造のために特に設計した装置（（三）に該当するものを除く。）

（三）　結晶の引上げ装置及び炉であって、次のいずれかに該当するもの

１　アニール装置及び再結晶のための装置（定温炉を除く。）であって、〇・〇〇五平方メートル毎分を超える速度でウエハーを処理できるエネルギー移動率を有するもの

２　プログラム内蔵方式の結晶の引上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの

一　るつぼを取り替えることなく再充塡できるもの

二　〇・二五メガパスカルを超える圧力で動作するもの

三　引き上げることができる結晶の直径が一〇〇ミリメートルを超えるもの

（四）　プログラム内蔵方式のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　二〇〇ミリメートル以上にわたり厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満となるシリコン膜を形成できるもの

２　ウエハー全体にわたり厚さの許容差の絶対値が三・五パーセント以下となるシリコン膜以外の膜を形成できるもの

３　処理中にウエハーを回転できるもの

（五）　分子線エピタキシャル成長装置

（六）　真空環境でウエハーを搬送するために特に設計したロードロック機能を備え、かつ、磁気的に強化されたスパッタリング装置

（七）　イオン注入、イオン増速拡散又は光増速拡散のために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　パターン形成を行うことができるもの

２　ビームエネルギーが二〇〇キロエレクトロンボルトを超えるもの

３　ビームエネルギーが一〇キロエレクトロンボルト未満で使用できるように設計したもの

４　加熱した基板に酸素を注入できるもの

（八）　プログラム内蔵方式の異方性ドライエッチング用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　バッチ方式のものであって、次のいずれかに該当するもの

一　終点検知機能を有するもの（発光分光式のものを除く。）

二　反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの

２　単一ウエハー方式のものであって、次のいずれかに該当するもの

一　終点検知機能を有するもの（発光分光式のものを除く。）

二　反応炉のエッチング圧力が二六・六六パスカル以下のもの

三　カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの

（九）　半導体素子製造用の化学的気相成長装置のうち、酸化物、窒化物、金属又は多結晶シリコンを堆積させることができるものであって、次のいずれかに該当するもの

１　〇・一メガパスカル未満の圧力で動作するもの

２　プラズマ増殖型のものであって、六〇パスカル未満の圧力で動作するもの並びに自動カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの

（十）　マスク、レチクル又は半導体素子の製造用に特に設計又は改造した電子ビーム装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　電子ビームを静電偏向させることができるもの

２　非ガウス形の電子ビーム形状を形成することができるもの

３　デジタルからアナログへの変換速度が三メガヘルツを超えるもの

４　デジタルからアナログへの変換精度が一二ビットを超えるもの

５　目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの

（十一）　ウエハーの表面仕上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　一〇〇マイクロメートルより薄いウエハーの裏面を加工し、かつ、加工後のウエハーを剥離することができるように特に設計したもの

２　加工されたウエハーの表面粗さを、二シグマ値で二マイクロメートル以下に仕上げるために特に設計した装置

（十二）　単一又は複数の真空チャンバーを搭載した相互接続用の装置であって、本条に該当する装置を統合するように特に設計したもの

（十三）　レーザー光を使用したモノリシック集積回路の修理又はトリミング用のプログラム内蔵方式の装置であって、次のいずれかに該当するもの

１　位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル未満のもの

２　照射面の直径（切り溝幅）が三マイクロメートル未満のもの

ロ　マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの（一）　完成したマスク及びレチクル（次のいずれかに該当するものを除く。）

１　第一条又は貨物等省令第六条第一号に該当しない集積回路を製造するためのもの

２　次の一及び二に該当するもの

一　設計寸法が二・五マイクロメートル以上のもの

二　製造用の装置又はソフトウエアによって使用目的を変更することができる特別な性質を有さないものとして設計したもの

（二）　マスク基板であって、次のいずれかに該当するもの

１　硬質表面で被覆したものであって、寸法が一二五ミリメートル四方を超えるもの

２　エックス線マスク用に特に設計したもの

（三）　半導体素子又は集積回路のＣＡＤプログラムを動作させるために特に設計した装置（汎用の電子計算機を除く。）

（四）　マスク又はレチクル製造用の装置及びその附属品であって、次のいずれかに該当するもの

１　光学方式によるステップアンドリピート方式の露光装置であって、次のいずれかに該当するもの

一　一〇〇ミリメートル四方を超える範囲に連続してパターンを焼き付けることができるもの

二　一回で六ミリメートル四方を超える範囲にパターンを焼き付けることができるもの

三　二・五マイクロメートル未満の線幅を基板上のフォトレジストに焼き付けることができるもの

２　イオンビーム又はレーザービームリソグラフィを用いたマスク又はレチクル製造用の装置であって、二・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの

３　マスク若しくはレチクルの改造又は欠陥除去用のペリクルの追加のための装置及びホルダー